

メタライズ / 金錫はんだ膜付き光学部品

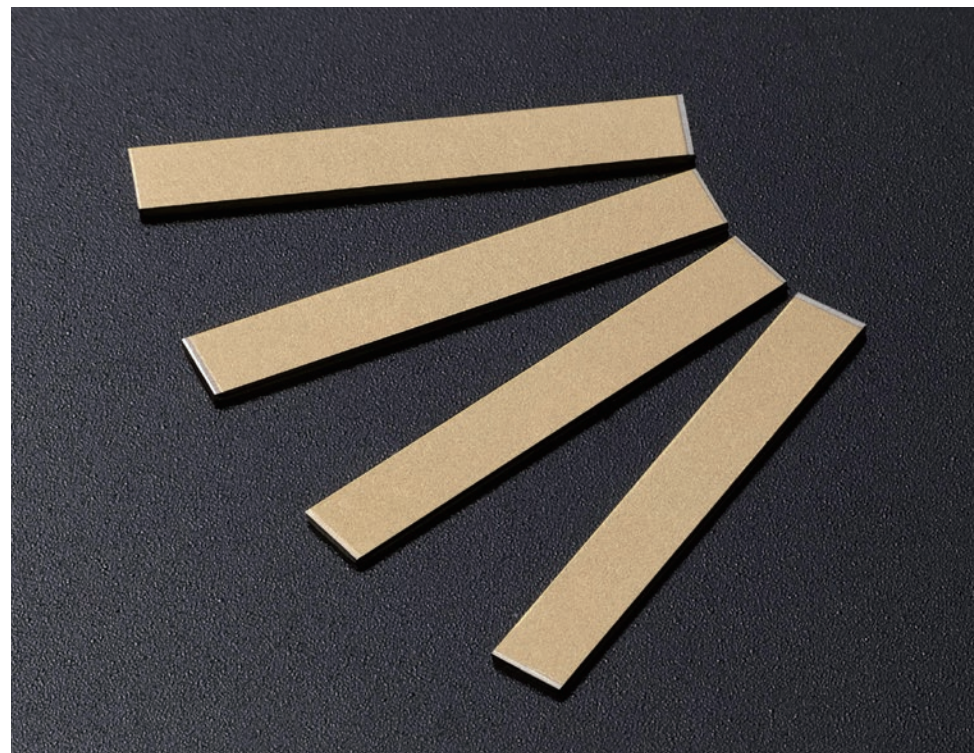
Optical Component with Metallization / AuSn Solder

お客様での実装を容易にするメタライズおよび金錫はんだ膜を施した光学部品です。
使用方法、接合方法に合わせて最適な膜仕様を提案します。

Optical component with metallization / AuSn solder contributes to the ease of mounting.
We propose optimum coating specification for your usage and bonding.

金錫はんだ膜付きサブマウント Submount with AuSn solder

お客様での実装を容易にする金錫はんだ膜を施したサブマウントです。ご希望の特性や接合条件に応じた材質の選択と膜調整が可能です。
Easy to handle, no need to prepare AuSn solder separately. Multiple base material options and Au/Sn solder customization for your needs.



用 途		Application
● 高出力LD用ヒートシンク	● Heat-sink for high-power LD modules	
特 長		Features
● 信頼性の高い強固な接合強度を実現	● High bonding strength	
● 金と錫の組成比や厚みを調整可能	● Customizable Au/Sn ratio and layer thickness	
● 下地膜 (メタライズ膜) の構成を調整可能	● Customizable metallized layer	
● パターン成膜を施すことが可能	● Pattern coating is available	
● ご希望特性に応じた材質を選択可能	● Selectable base material	

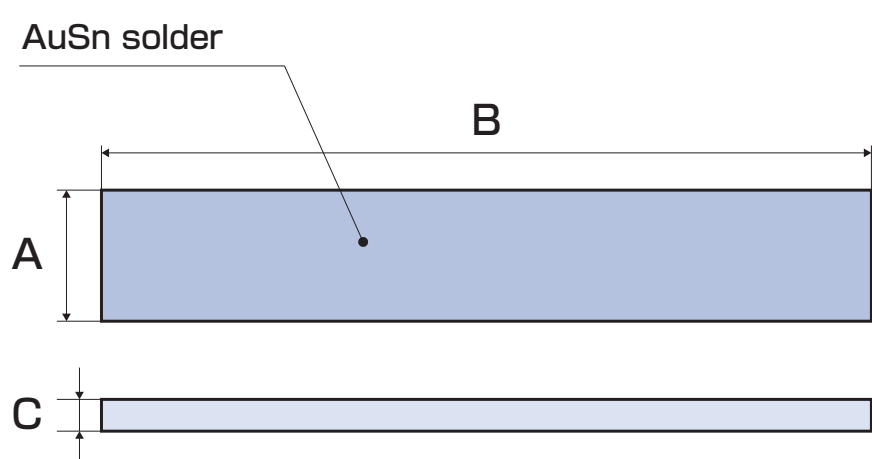
材 質 : CuW※1, CuMo※1, S-CMC※2, S-DBC※3,
Base material Graphite, Diamond, and others

※1 Santier, an EGIDE Company社製材料
※2 株式会社FJ コンポジット社製 銅・モリブデン 多層材料
※3 株式会社FJ コンポジット社製 セラミックス・銅 接合材料

【仕様例 : Specification example】

寸法 Dimensions(mm) :
A=1.50, B=10.00, C=0.25

組成比 ratio
Au : Sn = 78 : 22 (wt%)
膜厚 5 μ m
AuSn thickness



【材質特性 Base material properties】

		熱伝導率 (W/mK) Thermal conductivity (W/mK)		熱膨張係数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) CTE ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)
材 質 Base material	含有割合 Material ratio	板厚方向 Z-direction	面方向 XY-direction	室温 -250 $^{\circ}\text{C}$ RT -250 $^{\circ}\text{C}$
CuW	W = 90%	174	174	6.4
	W = 85%	188	188	7.3
	W = 80%	206	206	8.3
CuMo	Mo = 85%	130	130	6.6
	Mo = 70%	195	195	7.5
	Mo = 50%	220	220	9.9
S-CMC	Mo = 5%	362	381	14.8
	Mo = 10%	335	369	11.8
	Mo = 20%	291	344	7.4
	Mo = 40%	230	290	6.6

金錫はんだ膜付きマイクロプリズム Micro prism with AuSn solder メタライズ付き光素子用窓板 Optical window with metallization



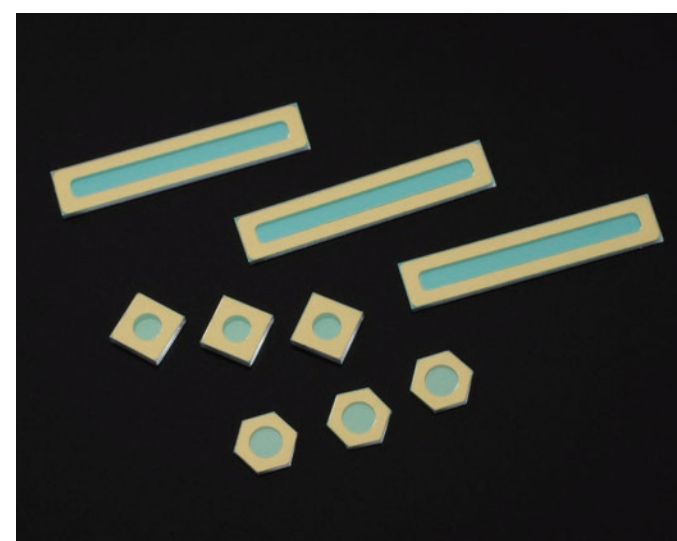
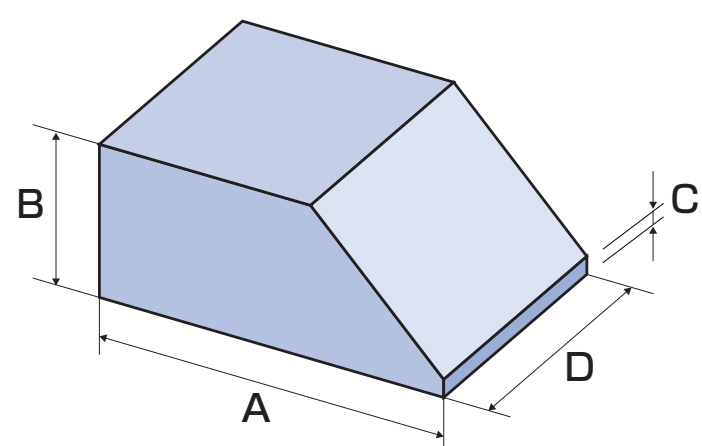
材 質 : ガラス
Material Glass

【仕様例 : Specification example】

寸法 Dimensions(mm) :
A=1.00, B=0.65, C=0.05, D=0.45

膜 : HRコート、金錫はんだ
Coating HR coating, AuSn solder

用 途	Application
● LDパッケージ用光取出し ● Light extraction for LD package	
特 長	Features
● 信頼性の高い強固な接合強度を実現 ● 金と錫の組成比や厚みを調整可能 ● 下地膜 (メタライズ膜) の構成を調整可能	
● High bonding strength ● Customizable Au/Sn ratio and layer thickness ● Customizable metallized layer	



材 質 : ガラス、サファイア
Material Glass, Sapphire

【仕様例 : Specification example】

寸法 Dimensions(mm) :
A=2.80, B=1.50, C=0.30

膜 : ARコート、メタライズ
Coating AR coating, metallization

用 途	Application
● LDパッケージ用射出窓 ● Optical window for LD package	
特 長	Features
● 下地膜 (メタライズ膜) の構成を調整可能 ● Customizable metallized layer	

